

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 20251216

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	泰康资产：陈玮璇、段中喆、商熠峰，华源证券：白宇、胡佳媛，共 5 名投资者及证券人员
时间	2025 年 12 月 16 日上午 10:00~11:30
地点	公司 9 楼会议室
上市公司接待人员姓名	2025 年 12 月 16 日上午 10:00~11:30: 董事会秘书杨平彩女士、投资者关系总监熊亚威先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司介绍:</p> <p>公司是国内领先的关键赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，主营业务横跨两大板块—半导体业务板块、打印复印通用耗材业务板块。现阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电路用 CMP 抛光垫国内供应龙头，占据 OLED 新型显示材料 YPI、PSPI 国内供应领先地位，深度布局半导体 KrF/ArF 晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务。此外，在打印复印通用耗材业务板块，公司全产业链布局，上游提供彩色聚合碳粉、显影辊等打印复印耗材核心原材料，下游销售硒鼓、墨盒两大终端耗材产品，实现产业上下游的联动，支持公司在该行业内的竞争优势地位。</p> <p>问 1：公司作为国内唯一能同时供应抛光垫、抛光液、清洗液多种 CMP 材料的企业，这种全链条布局在实际商业合作中，相比单一材料供应商能为客户创造哪些独特价值？目前该优势已转化为多少实际业务增量？</p> <p>答：公司 CMP 全链条布局的核心价值在于为客户提供“一站式”工艺解决方案，这也是我们区别于同业的核心竞争力之一。从客户需求来看，这种布局可大幅降低其多供应商管理成本，通过材料间的性能协同优化，提升芯片制造良率与生产效率——例如我们的抛光垫与抛光液可实现精准适配，较客户混合使用不同品牌产品时有效提高良率。从业务转化来看，2025 年</p>

前三季度公司 CMP 相关业务营收占半导体板块比重超 60%，其中“抛光液+清洗液”已在国内主流逻辑晶圆厂取得组合订单，金属栅极抛光液搭载自产氧化铝研磨粒子后，在存量客户端放量显著，全链条优势已成为客户拓展的核心抓手。

问 2：2025 年前三季度公司研发投入同比增长 16%，其中绝大部分投向半导体板块。能否具体说明这些研发投入在关键技术突破上的转化效率？比如在高端光刻胶领域，核心原材料自主研发的进展如何支撑产业化进程？

答：公司始终坚持“研发驱动产业化”的发展路径，2025 年前三季度研发投入已达 3.89 亿元，高投入已形成显著的技术转化成果。在高端晶圆光刻胶领域，我们已实现全链条核心原料自主研发，功能单体、主体树脂、含氟树脂等关键原料均能自主制备，彻底解决了高端光刻胶产业化的原材料问题。目前公司年产 30 吨 KrF/ArF 光刻胶产线已具备批量化生产能力，募集资金建设的年产 300 吨产业化项目正在稳步推进，达产后将有效缓解国内高端光刻胶供应紧张局面。从专利转化来看，截至 2025 年 6 月 30 日，公司已获授及在申请中的专利共 1,301 项，其中已获得授权的专利 1,052 项，进一步巩固了我们在该领域的国内领先地位。

问 3：2025 年前三季度公司半导体业务营收占总营收比重为 57%，其余为打印复印耗材业务，请问公司如何平衡两大业务板块的发展？

答：公司目前已明确半导体创新材料为核心发展方向，同时耗材业务作为稳定的现金流支撑，仍将维持行业领先地位。耗材业务的全产业链布局（从彩色聚合碳粉、显影辊等上游原料到硒鼓、墨盒下游终端产品），为公司积累了成熟的有机合成、高分子聚合、规模化生产管理及客户服务经验，这些能力已成功复用于半导体材料业务的产业化推进。2025 年前三季度打印复印通用耗材业务实现 11.53 亿元营收，经营现金流稳定，为半导体业务的研发投入和产能建设提供了坚实保障。

问 4：截至 2025 年 6 月 30 日，公司已获授权专利 1052 项，拥有七大核心技术平台。请问公司如何构建专利壁垒以防范行业竞争？这些技术平台的协同效应在新产品研发中如何体现？

答：公司高度重视知识产权保护，已构建起覆盖“核心原料-产品配方-生产工艺-应用方案”的全链条专利体系，1052 项授权专利中，发明专利占比超 37%。我们通过专利布局与技术秘密相结合的方式，形成了难以复制的技术壁垒，同时持续完善专利数据库建设，积极布局 CMP 抛光垫、抛光液、柔性显示 PSPI 等主要产品的核心专利，持续加大各类新产品在海内外的不侵权分析及风险排查，有效防范了技术侵权风险，为公司创新发展及市场推广保驾护航。七大核心技术平台（有机合成、无机非金属材料等）的协同效应是公司快速拓展新业务的关键，例如我们利用高分子合成、有机合成平台的技术积累开发光刻胶核心原料，借助无机非金属材料平台研发 CMP 研磨粒子，通过物理化学平台优化材料性能，这种跨平台协同使我们从技术研发到产业化的周期大幅缩短，成功实现了多个进口替代产品的快速落地。

问 5：公司多次提到“平台型公司”定位，这种定位在新业务拓展上有

	<p>哪些具体优势？</p> <p>答：“平台型公司”定位是公司区别于单一材料供应商的核心优势，主要体现在技术复用、客户复用、产业化能力复用三大方面。这一体系为新业务拓展提供了风险更低、效率更高、确定性更高的核心优势，具体体现在以下四大方面：第一，技术平台协同赋能，大幅缩短新业务研发周期。公司深耕创新材料领域超 20 年，已建成有机合成、无机非金属材料、物理化学等七大核心技术平台，各平台技术可跨业务复用。第二，客户资源复用，加速新业务市场导入。公司两大主营业务板块积累了优质且广泛的客户基础，半导体业务端已深度绑定国内主流晶圆厂、面板厂，耗材业务端覆盖全球打印耗材终端客户，这些客户资源可跨业务协同复用。第三，产业化能力复用，保障新业务快速落地。经过多年发展，公司已建成多个规模化生产基地，积累了高纯度材料制备、精密制造、质量管控、稳定交付等成熟的产业化经验，这些能力可全面复用于新业务的产能建设与量产推进。第四，全链条资源协同，构建新业务成本与竞争优势。公司在核心原材料自主研发、供应链管理、知识产权保护等方面全链条资源，可为新业务提供全方位支撑。综上，平台型定位使公司新业务拓展具备“技术有支撑、客户有基础、量产有保障、成本有优势”的独特竞争力，也是公司持续培育新增长曲线、实现长远发展的核心底气。</p> <p>问 6：当前国内半导体材料行业的竞争格局中，公司认为自身最核心的“护城河”是什么？从长期发展来看，公司如何在保持技术领先的同时，实现市场份额的持续提升？</p> <p>答：公司最核心的“护城河”，是二十余年积累的“全链条技术能力+产业化经验+客户深度绑定”的综合优势。首先，在技术层面，我们实现了从核心原料到终端产品的全链条自主研发，这种能力在国内极为稀缺，确保了我们在技术迭代中的主动权；其次，在产业化层面，我们已建成多个规模化生产基地，攻克了高纯度、高稳定性的生产工艺难题，产品良率不断提升；最后，在客户层面，我们与国内主流晶圆厂、面板厂建立了长期战略合作关系，深度参与客户技术升级过程，形成了难以替代的客户粘性。长期来看，我们将通过三大举措巩固优势：一是持续维持高于行业平均水平的研发投入，聚焦高端产品技术突破；二是根据下游需求加快产能建设，提升规模化供应能力，满足客户放量需求；三是深化“一站式”服务能力，通过多产品组合销售提升客户渗透率。我们坚信，凭借深厚的技术积淀和清晰的战略布局，公司将持续引领国内半导体材料的发展，实现市场份额与盈利能力的双重提升。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 12 月 16 日